

第 58 回高分子学会年次大会概要

- | | | |
|--------------|---|---|
| 1. 会 | 期 | 平成 21 年 5 月 27 日(水) ~ 29 日(金) |
| 2. 会 | 場 | 神戸国際会議場・国際展示場 (神戸市中央区港島中町) |
| 3. 内 | 容 | 1) 招待講演 (30 件)
2) 受賞講演 (11 件)
3) 特別セッション (17 件)
4) 研究発表 (2,060 件)
①口頭発表 (うち依頼発表) (685 件 (9 件))
②ポスター発表 (1,375 件) |
| 4. 参加者数 (予定) | | <u>約 4,000 名</u> |
| 5. 研究発表部門 | | |

〈一般テーマ〉

A. 高分子化学(高分子合成・高分子反応) [ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) ラジカル重合(開環ラジカル重合を含む)
- 2) イオン重合(アニオン重合、カチオン重合、光・放射線イオン重合、開環イオン重合、など)
- 3) 金属触媒重合(チーグララー・ナツタ触媒重合、メタロセン触媒重合、その他の金属触媒による重合、配位重合、開環金属触媒重合、など)
- 4) 重縮合
- 5) 重付加・付加縮合
- 6) 新しい重合反応・新モノマー(上記1)~5)と異なる機構の重合、新触媒、新規モノマー、など)
- 7) 特殊構造ポリマー(ブロックポリマー、グラフトポリマー、スターポリマー、多分岐ポリマー、 dendroliマー、共役系高分子、など)
- 8) 非共有結合型高分子(水素結合、配位結合、 π 電子相互作用などの分子間相互作用によってできた高分子および分子集合材料、など)
- 9) 高分子反応(高分子と低分子の反応、高分子分子内反応、高分子と高分子の反応、橋かけ、分解・劣化・安定化、など)
- 10) 新しい重合プロセス(新規重合プロセス、反応工学、プラント設計、成形・加工、など)
- 11) その他

B. 高分子構造・高分子物理(高分子構造・基礎物性・運動性の関連) [口頭 or ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) 分子特性解析(コンフィギュレーション、コンホメーション、電子構造、分子量、分子量分布、共重合体組成、など)
- 2) 固体[(a) 結晶、非晶、高次組織(結晶、非晶、高次組織の構造と物性、相転移、モルホロジー、結晶化、分子運動性、など)(b) 固体基礎物性(力学的性質、熱的性質、電気的性質、光学的性質、など)(c) アロイ・ブレンド・コンポジット(アロイ・ブレンド・コンポジットの構造、物性、相分離構造形成過程、など)]
- 3) 溶液・融液・レオロジー・ダイナミクス[(a) 溶液・融液(希薄溶液・準濃厚溶液・濃厚溶液・融液の構造・性質・分子運動、電解質、など)(b) レオロジー・ダイナミクス(分子動力学、多相系、サスペンション、エマルジョン、流動力学、成形加工、など)]
- 4) 液晶(高分子液晶、サーモトロピック液晶、リोटロピック液晶、など)
- 5) ゲル・ネットワークポリマー(ゲルの構造・形成過程・物性・ダイナミクス、エラストマー、熱硬化性高分子、など)
- 6) 表面・界面・薄膜(表面・界面の構造・物性、薄膜の構造・物性、界面組織体・分子集合体・単分子膜・LB膜、表面力・ナノレオロジー・トライボロジー、微粒子・コロイド、など)
- 7) 高分子の分析法
- 8) その他

C. 高分子機能(高分子の機能化・高性能化) [口頭 or ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) 光(フォトニクス、光ディスク、レジスト、微細パターン形成法、光スイッチ、PHB、非線形光学、など)
- 2) 電気・電子・磁性(エレクトロニクス、磁性材料、イオン導電体、強誘電体、電子導電体、半導体、絶縁材料、配線、電子スイッチ、電池、など)
- 3) 分離・認識・触媒(光学異性体分離、ガス分離、分子認識、高分子錯体、など)
- 4) 耐熱・難燃性高分子
- 5) 高強度・高弾性率高分子
- 6) 極限物性(極低温、超高温、高圧、高真空、など)
- 7) 液晶(液晶の機能化)
- 8) ゲル(ゲルの機能化)
- 9) 表面・薄膜(表面・薄膜の機能化)
- 10) その他

D. 生体高分子および生体関連高分子 [ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) ポリペプチド、タンパク質、酵素
- 2) 核酸と関連化合物
- 3) 多糖、糖質高分子
- 4) 生体膜、人工膜
- 5) バイオミメティクス(生体モデル高分子、分子認識・応答システム、など)
- 6) 生物工学(遺伝子、細胞、微生物、など)
- 7) ライフサイエンス(人工血液、抗血栓性、ドラッグデリバリー、歯科材料、遺伝子、など)
- 8) その他

E. 環境と高分子 [ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) 環境調和高分子材料(生分解性、省資源・省エネルギー材料、無毒無害材料、など)
- 2) 環境調和高分子プロセス(省資源・省エネルギー合成、安全な廃棄・焼却、など)
- 3) 高分子リサイクル(高分子のリサイクルプロセス、リサイクル材料、リサイクル向け混和剤、など)
- 4) その他

F. 高分子工業・工学(工業材料と工業技術) [口頭 or ポスターor 口頭(英語のみ)]

- 1) 構造材料(自動車車両・航空機・船舶、OA器機、電気製品、建築・土木、など)
- 2) 生活製品(食品、化粧品、フィルム、シート、塗料、接着、繊維、紙、印刷、衛生材料、包装、など)
- 3) 改質(強化剤、安定剤、難燃剤、表面改質・処理、発泡、など)
- 4) 成形加工(成形加工法、など)
- 5) マルチメディア関連(ディスプレイ、電池、記録、通信、LSI、など)
- 6) その他